2026年12月期　第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2026年11月13日

上 場 会 社 名　　株式会社ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ　　上場取引所　東
コ ー ド 番 号　　3445　　URL　https://www.rs-tec.jp
代　　表　　者　（役職名）　代表取締役社長　　（氏名）　方　永義
問合せ先責任者　（役職名）　取締役 経営管理本部長　　（氏名）　戸松　清秀　　（TEL）03(5709)7685

配当支払開始予定日　　ー
決算補足説明資料作成の有無　　：有
決算説明会開催の有無　　：無

（百万円未満切捨て）

１．2026年12月期第３四半期の連結業績（2026年１月１日～2026年９月30日）

（１）連結経営成績(累計)

（%表示は、対前年同四半期増減率）

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2026年12月期第３四半期	65,021	11.0	12,599	13.9	13,276	10.5	7,917	18.7
2025年12月期第３四半期	58,583	31.5	11,062	14.4	12,018	8.5	6,669	19.2

（注）包括利益　2026年12月期第３四半期　17,032百万円（ 218.1%）　2025年12月期第３四半期　5,355百万円（△48.7%）

	１株当たり四半期純利益	潜在株式調整後１株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
2026年12月期第３四半期	297.86	297.26
2025年12月期第３四半期	252.22	251.19

（２）連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2026年12月期第３四半期	236,617	184,781	38.8
2025年12月期	205,222	153,331	39.1

（参考）自己資本　2026年12月期第３四半期　91,703百万円　　2025年12月期　80,151百万円

２．配当の状況

	年間配当金				
	第１四半期末	第２四半期末	第３四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2025年12月期	ー	0.00	ー	45.00	45.00
2026年12月期	ー	0.00	ー		
2026年12月期(予想)				55.00	55.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無　　：　無

３．2026年12月期の連結業績予想（2026年１月１日～2026年12月31日）

（%表示は、対前期増減率）

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		１株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	84,000	9.5	15,400	7.8	17,200	3.4	10,000	7.6	376.54

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無　　：　無

※　注記事項

（１）当四半期連結累計期間における連結範囲の重要な変更　　：有

新規　　２社（社名）　国晶半導体材料（包頭）有限公司、安徽晶隆半導体科技有限公司

除外　　ー社（社名）　ー

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用　　：無

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

①　会計基準等の改正に伴う会計方針の変更　　：無

②　①以外の会計方針の変更　　：無

③　会計上の見積りの変更　　：無

④　修正再表示　　：無

（４）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む）	2026年12月期３Ｑ	26,597,800株	2025年12月期	26,558,502株
②　期末自己株式数	2026年12月期３Ｑ	1,190株	2025年12月期	1,142株
③　期中平均株式数（四半期累計）	2026年12月期３Ｑ	26,580,688株	2025年12月期３Ｑ	26,444,124株

※　添付される四半期連結財務諸表に対する公認会計士又は監査法人によるレビュー　：無

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手している情報及び合理的であると判断する前提に基づいたものであり、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

○添付資料の目次

１．当四半期連結累計期間の経営成績等の概況 …… 2
２．四半期連結財務諸表及び主な注記 …… 3
（１）四半期連結貸借対照表 …… 3
（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 …… 5
四半期連結損益計算書 …… 5
第３四半期連結累計期間 …… 5
四半期連結包括利益計算書 …… 6
第３四半期連結累計期間 …… 6
（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 …… 7
（セグメント情報等の注記） …… 7
（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） …… 9
（継続企業の前提に関する注記） ……10
（キャッシュ・フロー計算書に関する注記） ……10
（企業結合等関係） ……10
（重要な後発事象） ……11

１．当四半期連結累計期間の経営成績等の概況

当該内容は、本日ＴＤｎｅｔで開示した「2026年度12月期第３四半期決算説明資料」において記載しております。

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

（単位：百万円）

	前連結会計年度 (2025年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2026年９月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	96,771	98,931
受取手形及び売掛金	22,322	26,512
商品及び製品	5,677	5,312
仕掛品	2,255	3,239
原材料及び貯蔵品	5,033	4,649
その他	3,397	3,552
貸倒引当金	△103	△122
流動資産合計	135,354	142,076
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	16,911	17,781
機械装置及び運搬具（純額）	22,030	24,949
その他（純額）	6,217	13,230
建設仮勘定	4,326	15,819
有形固定資産合計	49,485	71,781
無形固定資産		
その他	669	697
無形固定資産合計	669	697
投資その他の資産		
投資有価証券	17,615	18,970
破産更生債権等	0	0
その他	2,097	3,091
貸倒引当金	△0	△0
投資その他の資産合計	19,712	22,062
固定資産合計	69,867	94,540
資産合計	205,222	236,617
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	9,890	11,262
短期借入金	3,700	400
1年内返済予定の長期借入金	2,930	2,428
未払金	9,276	9,587
未払法人税等	1,571	2,364
賞与引当金	931	1,014
その他	2,985	3,372
流動負債合計	31,286	30,428
固定負債		
長期借入金	14,135	7,612
役員退職慰労引当金	3	4
退職給付に係る負債	10	8
繰延税金負債	3,715	4,650
その他	2,740	9,129
固定負債合計	20,605	21,406
負債合計	51,891	51,835

（単位：百万円）

	前連結会計年度 (2025年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2026年９月30日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	5,860	5,931
資本剰余金	15,913	18,081
利益剰余金	48,010	54,732
自己株式	△2	△2
株主資本合計	69,782	78,743
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	971	1,963
為替換算調整勘定	9,398	10,996
その他の包括利益累計額合計	10,369	12,959
新株予約権	63	51
非支配株主持分	73,116	93,026
純資産合計	153,331	184,781
負債純資産合計	205,222	236,617

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第３四半期連結累計期間

（単位：百万円）

	前第３四半期連結累計期間 （自 2025年１月１日 至 2025年９月30日）	当第３四半期連結累計期間 （自 2026年１月１日 至 2026年９月30日）
売上高	58,583	65,021
売上原価	40,574	44,839
売上総利益	18,008	20,182
販売費及び一般管理費	6,945	7,582
営業利益	11,062	12,599
営業外収益		
受取利息	1,061	918
為替差益	－	21
補助金収入	1,152	882
その他	146	174
営業外収益合計	2,360	1,996
営業外費用		
支払利息	131	245
持分法による投資損失	780	996
為替差損	462	－
その他	30	78
営業外費用合計	1,404	1,319
経常利益	12,018	13,276
特別利益		
負ののれん発生益	367	1,585
特別利益合計	367	1,585
特別損失		
固定資産除却損	118	－
特別損失合計	118	－
税金等調整前四半期純利益	12,268	14,861
法人税、住民税及び事業税	2,812	3,530
法人税等調整額	425	367
法人税等合計	3,238	3,898
四半期純利益	9,029	10,963
非支配株主に帰属する四半期純利益	2,360	3,045
親会社株主に帰属する四半期純利益	6,669	7,917

四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

（単位：百万円）

	前第３四半期連結累計期間 （自 2025年１月１日 至 2025年９月30日）	当第３四半期連結累計期間 （自 2026年１月１日 至 2026年９月30日）
四半期純利益	9,029	10,963
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	506	992
為替換算調整勘定	△3,639	4,390
持分法適用会社に対する持分相当額	△542	686
その他の包括利益合計	△3,674	6,069
四半期包括利益	5,355	17,032
（内訳）		
親会社株主に係る四半期包括利益	5,489	10,507
非支配株主に係る四半期包括利益	△134	6,524

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（セグメント情報等の注記）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間(自　2025年１月１日　至　2025年９月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

（単位：百万円）

	報告セグメント				その他（注）１	合計	調整額（注）２	四半期連結財務諸表計上額（注）３
	ウェーハ再生事業	プライムシリコンウェーハ製造販売事業	半導体関連装置・部材等	計				
売上高								
物品の販売	7,158	13,731	24,278	45,169	161	45,330	－	45,330
顧客提供物の加工	13,253	－	－	13,253	－	13,253	－	13,253
外部顧客への売上高	20,411	13,731	24,278	58,422	161	58,583	－	58,583
セグメント間の内部売上高又は振替高	0	1,520	－	1,520	－	1,520	△1,520	－
計	20,412	15,251	24,278	59,942	161	60,103	△1,520	58,583
セグメント利益	7,421	3,313	1,623	12,359	1	12,360	△1,297	11,062

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ソーラー事業、技術コンサルティングであります。

２．　調整額は以下のとおりであります。

セグメント利益の調整額は、各報告セグメントには配賦していない全社費用及び棚卸資産に係る未実現利益であります。全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

３．　セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（重要な負ののれん発生益）

「半導体関連装置・部材等」セグメントにおいて、2024年12月27日に株式を取得した艾索精密部件（惠州）有限公司の条件付取得対価の総額が確定したことにより、新たに負ののれん発生益が367百万円発生しております。なお、負ののれん発生益の金額は、前連結会計期間末において取得原価の配分が完了しておらず、暫定的に算定された金額でありましたが、当第３四半期連結会計期間末までに確定しております。この暫定的な会計処理の確定に伴う金額の変動はありません。

また、負ののれん発生益は特別利益のため、セグメント利益には含まれておりません。

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間(自　2026年１月１日　至　2026年９月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

（単位：百万円）

	報告セグメント				その他（注）１	合計	調整額（注）２	四半期連結財務諸表計上額（注）３
	ウェーハ再生事業	プライムシリコンウェーハ製造販売事業	半導体関連装置・部材等	計				
売上高								
物品の販売	7,081	21,080	21,967	50,130	113	50,243	－	50,243
顧客提供物の加工	14,778	－	－	14,778	－	14,778	－	14,778
外部顧客への売上高	21,860	21,080	21,967	64,908	113	65,021	－	65,021
セグメント間の内部売上高又は振替高	1	1,761	2	1,765	39	1,804	△1,804	－
計	21,861	22,842	21,969	66,673	152	66,826	△1,804	65,021
セグメント利益又は損失（△）	7,668	5,235	1,182	14,086	△10	14,075	△1,476	12,599

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ソーラー事業、技術コンサルティングであります。

２．　調整額は以下のとおりであります。

セグメント利益又は損失の調整額は、各報告セグメントには配賦していない全社費用及び棚卸資産に係る未実現利益であります。全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

３．　セグメント利益又は損失は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（重要な負ののれん発生益）

「プライムシリコンウェーハ製造販売事業」セグメントにおいて、2026年７月６日に安徽晶隆半導体科技有限公司を取得し、連結子会社化しました。これに伴い、負ののれん発生益を1,585百万円計上しております。

また、負ののれん発生益は特別利益のため、セグメント利益又は損失には含まれておりません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

前第３四半期連結累計期間(自　2025年１月１日　至　2025年９月30日)

１　配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額（百万円）	１株当たりの配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
2025年２月19日取締役会	普通株式	924	35	2024年12月31日	2025年３月11日	利益剰余金

２　基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

当第３四半期連結累計期間(自　2026年１月１日　至　2026年９月30日)

１　配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額（百万円）	１株当たりの配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
2026年２月13日取締役会	普通株式	1,195	45	2025年12月31日	2026年３月10日	利益剰余金

２　基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

３　株主資本の金額の著しい変動

当第３四半期連結累計期間において、当社の連結子会社である有研半導体硅材料股份公司の株式を売却したこと等により、資本剰余金が2,167百万円増加しております。この結果、当第３四半期連結累計期間末において資本剰余金が18,081百万円となっております。

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（キャッシュ・フロー計算書に関する注記）

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は次のとおりであります。

	前第３四半期連結累計期間 （自　2025年１月１日 至　2025年９月30日）	当第３四半期連結累計期間 （自　2026年１月１日 至　2026年９月30日）
減価償却費	4,086百万円	4,691百万円

（企業結合等関係）

（取得による企業結合）

(1)企業結合の概要

①被取得企業の名称及びその取得した事業の概要

被取得企業の名称　安徽晶隆半導体科技有限公司

事業内容　エピタキシャルウェーハの研究開発・製造・販売および半導体材料関連事業

②企業結合を行った主な理由

当社は、2018年１月にM&Aにより有研半導体硅材料股份公司を連結子会社化して以来、パワー半導体向け８インチプライムウェーハを主力製品として、プライムウェーハの製造・販売事業を展開してまいりました。

近年、AI、EV及びパワーデバイス市場の拡大と技術進化を背景に、高性能半導体材料市場は成長を続けております。中でもエピタキシャルウェーハは、先進パワーデバイス向け基板材料として需要の拡大が見込まれており、当社グループでは、エピタキシャル技術を活用した高付加価値製品分野を中長期的な成長ドライバーと位置付けております。

このような認識のもと、当社のプライムウェーハ事業とのシナジー創出及び事業ポートフォリオの高度化を目指したエピタキシャル関連事業への早期参入を目的に、エピタキシャルウェーハの製造販売を主力事業とする「安徽晶隆半導体科技有限公司」を子会社化することを決定いたしました。これにより、高付加価値ウェーハの製造が可能となり、当社グループの競争優位性の向上を図るとともに、収益基盤の強化及び収益性の安定化に寄与するものと考えております。

③企業結合日

2026年7月6日（持分取得日）

2026年7月1日（みなし取得日）

④結合後企業の名称

変更はありません。

⑤企業結合の法的形式

現金を対価とする持分の取得

⑥取得企業を決定するに至った主な根拠

当社の連結子会社である有研半導体硅材料股份公司が現金を対価として持分を取得したためであります。

⑦取得した議決権比率

60%

(2)四半期連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

2026年7月1日から2026年9月30日までを業績に含めております。

(3)取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得の対価　現金	10,758百万円
取得原価	10,758百万円

(4)主要な取得関連費用の内容及び金額

アドバイザー等に対する手数料・報酬　48百万円

(5)発生した負ののれん発生益の金額、発生原因

①発生した負ののれん発生益の金額

1,585百万円

②発生原因

被取得企業の企業結合時の時価純資産額が取得原価を上回ったため、その差額を負ののれん発生益として計上するものです。

(6)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産	19,202百万円
固定資産	9,821百万円
資産合計	29,023百万円
流動負債	836百万円
固定負債	3,503百万円
負債合計	4,339百万円

(7)企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響の概算額及びその算定方法

当該影響の概算額に重要性が乏しいため、記載を省略しています。

（重要な後発事象）

（連結子会社の解散及び清算）

当社は、2026年10月９日付の取締役会（書面決議）において、当社の連結子会社である艾索精密部件（惠州）有限公司を解散及び清算することを決議いたしました。

(1)理由

当社は、2024年12月に索尼精密部件（惠州）有限公司の事業を承継し、艾索精密部件（惠州）有限公司（以下「同社」）を設立いたしました。同社では、既存事業である光学ピックアップ事業を継続するとともに、中長期的な成長に向けた新たな収益基盤の構築を目的として、車載カメラモジュール事業への参入に向けた事業基盤の構築を進めてまいりました。

しかしながら、市場環境、競争環境、収益性及び事業体制等の検討を重ねた結果、中国市場を中心に車載カメラモジュール市場の成長は引き続き見込まれるものの、市場競争の激化に伴う価格競争が想定以上に厳しく、中長期的に当社グループが期待する収益水準を確保することは困難であると判断し、同事業への参入を中止することといたしました。

また、既存事業である光学ピックアップ事業についても、市場縮小が進展する中、将来の成長性及び収益性を総

合的に勘案した結果、今後当該事業を継続しないこととといたしました。

このような状況を踏まえ、当社グループの経営資源をより収益性及び成長性の高い分野へ集中することが中長期的な企業価値向上に資すると判断し、同社を解散及び清算することを決定いたしました。

(2)解散及び清算する子会社の概要

①名称	艾索精密部件（惠州）有限公司
②所在地	中華人民共和国恵州市
③事業の内容	光学ピックアップモジュール・車載カメラモジュールの製造・販売
④資本金	79百万米ドル
⑤設立年月日	1995年11月20日（2024年12月に当社連結子会社化）
⑥議決権の所有割合	100％

(3)解散及び清算の時期

2027年5月（予定）

(4)解散及び清算が損益に与える影響

本件に伴い、固定資産の除却等による特別損失の計上を見込んでおりますが、その影響額は精査中であります。